

股票简称：澄天伟业

股票代码：300689



**深圳市澄天伟业科技股份有限公司
SHENZHEN CHENGTIAN WEIYE
TECHNOLOGY CO.,LTD.**

(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B3401-B3404)

**2026 年度
向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告**

二〇二六年一月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元，%

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金	占募集资金总量比例
1	液冷散热系统产业化项目	36,188.45	35,500.00	44.38
2	半导体封装材料扩产项目	26,228.28	25,800.00	32.25
3	液冷研发中心及集团信息化建设项目	11,391.57	10,700.00	13.38
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	10.00
合计		81,808.30	80,000.00	100.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金等自筹方式解决。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的实施背景

1、海内外数据中心建设加速，液冷需求持续提升

随着 AI 大模型向万亿参数级演进及混合专家模型（MoE）技术的广泛应用，算力密集型应用呈现井喷式增长，海量并行计算与高速数据交互需求亦随之呈指数级上升。人工智能数据中心（AIDC）作为算力生产与分发的核心枢纽，已成为支撑人工智能数字经济发展的关键数字底座。在全球范围内，科技巨头对算力资源的储备已进入战略竞速阶段，资本开支持续高位运行；国内方面，头部互联网企业明确未来三年在智算基础设施的投入将超过过去十年总和，彰显了行业对智算基建确定性增长的高度共识。

高性能计算与 AI 训练驱动单机柜功率密度持续攀升。在单体芯片功耗突破

1000W 的技术拐点下，风冷散热已难以满足严苛的温控需求，散热技术向液冷迭代成为行业必然。液冷技术凭借卓越的散热效率和能效优势，能够完美适配高密度算力场景，目前已成为 AIDC 的主流技术路径，支撑着算力产业规模的持续扩张。

2、顺应先进封装发展趋势，面向 AI 时代多类型芯片升级提升关键材料国产化配套能力

AI 产业浪潮带来的升级并非仅集中于算力芯片。随着人工智能进入“万物智能”时代，AI 芯片的升级已不仅限于逻辑算力，更涵盖了高带宽存储（HBM）、高性能电源管理芯片（PMIC）及异构集成芯片等全产业链的协同演进。散热与信号传输效率已成为制约 AI 芯片性能释放的关键边界，这驱动封装技术向“高密度、小型化及异构集成（Chiplet）”等先进领域加速迭代。

先进封装对基板材料、高端引线框架等关键主材的导热性、高精度及可靠性提出了近乎苛刻的要求。目前，全球高端引线框架市场仍由少数跨国企业占据，在复杂多变的国际贸易环境下，实现关键半导体材料的国产化配套已成为保障我国产业链韧性与安全的核心环节。公司通过本次募投项目的实施，旨在深耕先进封装材料领域，突破高端产品技术壁垒，在满足 AI 时代多类型芯片升级需求的同时，提升我国关键半导体材料的国产化率及国际竞争力。

3、持续深化公司发展战略，推动公司高质量跨越发展

围绕公司“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，公司本次募投项目重点投向液冷散热产品和半导体材料领域，依托公司在材料研发、精密制造及工程化能力方面的长期积累，向产业链技术含量和附加值更高的环节延伸。通过加大在高效散热解决方案和关键基础材料领域的布局，公司有望进一步提升核心技术水平和产品竞争力，拓展在算力基础设施及半导体等下游高景气领域的应用空间，优化业务结构与盈利能力，推动公司实现高质量、可持续的跨越式发展。

4、资本市场引导金融资源向科技创新和现代化产业体系集聚

2024 年 4 月，中华人民共和国国务院印发《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确提出资本市场要突出“金融为民”

理念，牢牢把握高质量发展这一主题，更加有力地服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设，进一步强化资本市场对实体经济和科技创新的支撑功能。

同月，中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，明确提出加大对科技型企业再融资的支持力度，着力提升再融资的有效性和便利性，引导上市公司将募集资金重点投向符合国家经济发展战略和产业政策导向的相关领域，充分发挥资本市场在优化资源配置、支持科技创新中的重要作用。

2025年2月，证监会进一步发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，强调要围绕科技创新和新质生产力发展需要，完善多层次资本市场体系，增强制度包容性和适应性。《实施意见》提出，对科技企业的支持将更加注重“全生命周期”服务，持续提升资本市场对科技创新型企业的精准支持力度。

在上述政策持续推动下，资本市场服务科技创新和战略性新兴产业的功能不断强化，有利于引导金融资源向高端制造、先进材料等重点领域加速集聚，为培育和壮大新质生产力提供更加坚实的制度保障和资金支持，推动“科创沃土”持续孕育更多高质量发展成果。

三、本次募集资金投资项目基本情况

（一）液冷散热系统产业化项目

1、项目内容概述

要素	内容
项目名称	液冷散热系统产业化项目
项目实施主体	澄天科泰（惠州）
项目实施地点	广东省惠州市已租赁场地
项目建设期	30个月
项目主要建设内容	本项目购买液冷先进生产设备、检测设备及相关配套设施建设等，提升公司规模化生产和交付能力。

2、项目投资概况

本项目计划投资资金36,188.45万元，其中，装修改造1,592.42万元，软硬件购置30,396.03万元，铺底流动资金4,200.00万元，拟使用募集资金35,500.00万元，投资构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比（%）
1	装修改造	1,592.42	4.40
2	软硬件购置	30,396.03	83.99
3	铺底流动资金	4,200.00	11.61
	项目总投资	36,188.45	100.00

3、项目实施的必要性

(1) 能耗与功率密度快速提升推动算力设施冷却需求升级，液冷凭借综合优势成为主流散热方案，市场空间广阔

随着人工智能、大数据和云计算技术加速发展，算力设施能耗持续攀升，芯片功耗和功率密度的快速增长成为数据中心能耗上升的核心驱动因素。为满足大模型训练与推理需求，GPU 功耗显著提升。在高算力密集部署模式下，单机柜功耗大幅提高，热量在有限空间内高度聚集，高温环境将通过触发降频、增加错误率及加速硬件老化等方式，严重制约算力释放与系统稳定运行，高效散热已成为保障算力性能的关键基础条件。

传统风冷方案受限于空气导热效率低、能源利用率不高及环境适应性较差等固有缺陷，已难以满足高功率密度数据中心的散热需求，而液冷通过以液体替代空气作为冷却介质，可显著提升散热效率和能源利用水平，已逐步成为高密度算力设施的主流散热技术路径。根据 IDC 数据，中国液冷服务器市场规模于 2024 年达到 23.7 亿美元，同比增长 67.0%，预计 2029 年将增至 162 亿美元，年复合增长率达 46.8%。随着人工智能应用的进一步深化，高算力场景持续涌现，液冷散热方案具备广阔的发展空间和良好的市场前景。

(2) 高价值 AI 服务器对液冷产品的质量与可靠性提出了极高要求

公司液冷产品主要应用于 AI 服务器及高性能计算系统的液冷回路，与服务器核心部件直接接触，其性能和稳定性直接关系到整机运行安全。随着 AI 算力需求快速增长，高端 GPU 芯片价格高昂、服务器整体价值显著提升，一旦发生漏液、污染或热失控等风险事件，可能造成重大经济损失，下游整机厂商因此对液冷产品在质量一致性、可靠性和长期稳定性方面提出了更为严苛的标准。

基于上述行业特征和客户需求，公司有必要通过引进先进生产与检测设备，

建设高标准生产车间，并实施覆盖原材料、制造过程及成品交付的全流程质量管控体系，持续提升液冷产品的质量水平和可靠性，为高端 AI 服务器客户提供稳定、安全的配套支持。

（3）顺应产业链延伸的战略需求，推动液冷业务做大做强

公司紧抓 AI 服务器、高性能计算及 AIDC 建设带来的散热需求快速增长机遇，依托在高导热金属材料、精密蚀刻、电镀及金属焊接等半导体封装领域长期积累的核心工艺优势，顺势切入液冷热管理赛道，推动业务由“封装材料”向“散热结构件”并进一步向“系统级液冷解决方案”的自然延伸。

随着算力密度持续提升，液冷散热技术正逐步成为服务器散热的主流方案，液冷模块单体价值不断提高，系统级液冷解决方案有望成为服务器整机厂商差异化竞争的重要抓手。公司聚焦液冷产品方向，该业务所处赛道成长性突出，有助于发展新的业绩增长点，推动公司实现高质量、可持续发展。

4、项目实施的可行性

（1）国家政策支持产业发展，为项目提供良好的外部环境

公司液冷产品主要应用于 AI 服务器、高性能计算等对散热性能要求极高的场景。近年来，国家出台了一系列政策鼓励和扶持行业，以推动人工智能、智算中心、液冷等相关产业的技术进步和行业持续健康发展。2023 年 2 月国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，提出系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。2024 年 7 月，国家发改委发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，提出要推广应用节能技术装备。因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到 2027 年，率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合。2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。

综上所述，相关规划和产业政策大力支持人工智能、智算中心、液冷等相關行业的持续发展，本项目符合国家的政策导向，相关政策为项目的开展提供了有利的宏观环境和政策基础，创造了良好的发展机遇。

（2）公司具备液冷技术和人才积累，为本次募投项目的顺利实施提供了可靠的基础

公司长期深耕半导体封装关键材料与精密制造领域，在高导热金属材料选型与加工、精密蚀刻成形、表面电镀与涂覆、精密冲压与成形、清洗与洁净控制、钎焊与扩散连接以及结构件密封与可靠性验证等方面，已建立较为系统的工艺体系和工程化经验，并拥有各类专业技术人才。上述核心工艺在材料体系、微结构加工、表面处理、连接工艺及可靠性控制等维度，与液冷产品的关键制造环节具有高度共通性，可直接复用于冷板、分配歧管、连接件等液冷核心部件，有助于缩短研发验证周期、提升良率爬坡效率，并为项目按期达产达效提供有力技术保障。

在此基础上，公司将半导体封装领域形成的应用与散热结构一体化设计经验引入液冷产品开发，成功研制出高导热、耐腐蚀的新型液冷模块，实现散热结构与液冷通道的深度集成，在导热效率、结构强度及系统可靠性等方面具备一定优势。通过融合热设计仿真、材料选型、精密加工制造与液冷路径优化等多领域技术，公司已具备向客户提供一体化液冷解决方案的能力。目前，公司液冷产品已完成多轮内部及客户侧技术验证，并顺利通过部分客户样品测试认证，已实现小批量产品订单交付，进一步印证了本次募投项目在技术层面的可行性。

5、项目建设涉及的政府报批情况

截至本报告出具日，本项目的备案、环评等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

6、本项目的经济效益

本项目有助于扩大业务规模，具有良好的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

(二) 半导体封装材料扩产项目

1、项目内容概述

要素	内容
项目名称	半导体封装材料扩产项目
项目实施主体	宁波澄天
项目实施地点	浙江省宁波市慈溪市宁波澄天现有厂房
项目建设期	30 个月
项目主要建设内容	本项目围绕公司半导体封装材料业务需求，对现有生产场地进行装修改造，购置先进的加工生产设备，部署信息化软硬件，在半导体封装材料领域进行业务扩张，增强公司的市场竞争力。

2、项目投资概况

本项目计划投资资金 26,228.28 万元，其中，装修改造 859.95 万元，软硬件购置 22,168.33 万元，铺底流动资金 3,200.00 万元，拟使用募集资金 25,800.00 万元，投资构成如下：

序号	项目	投资金额(万元)	占比(%)
1	装修改造	859.95	3.28
2	软硬件购置	22,168.33	84.52
3	铺底流动资金	3,200.00	12.20
项目总投资		26,228.28	100.00

3、项目实施的必要性

(1) 国产替代趋势下订单需求快速增长，项目促进公司进一步扩大业务规模

半导体封装材料为公司新拓展业务，近年来公司依托自身在封装材料设计、生产与实验室验证方面的技术积累，以及专用芯片封装领域的工艺与制造基础，从专用芯片封装拓展至功率半导体封装材料领域，构建了从产品设计、材料开发到制造交付的一体化能力体系。当前，公司已实现半导体封装材料的自主设计与量产落地，产品可全面覆盖 MOSFET、IGBT、SiC 及功率模块等产品的封装需求。封装材料是集成电路封装技术的关键支撑，市场空间发展大。随着政策支持和产业发展，国内企业在部分封装材料领域已取得一定技术突破，市场占有率逐

渐提升，但目前半导体封装材料的国产化主要集中于中低端，而高端封装材料领域仍有较大的替代空间。并且，得益于新能源汽车三电系统、储能系统及光伏逆变器等应用领域的发展，功率电子应用呈现快速扩张趋势，半导体封装材料的市场需求持续旺盛。因此公司抓紧行业发展机遇，持续加大半导体封装材料业务市场开拓力度，凭借优秀的产品质量赢得了下游客户的高度认可，订单需求增长下公司产品销售业绩快速增长。

本项目公司计划对现有场地进行装修改造，并购置一系列先进生产软硬件设备，从而新增自动化生产产线，增加公司引线框架和高导热铜针式散热底板产品产能。近年来，半导体封装材料国产化趋势叠加下游行业应用增长，相关产品市场需求持续旺盛，公司半导体封装材料产品产能利用率持续攀升，项目的实施是公司满足快速增长订单需求的必要举措，有利于公司进一步扩大半导体封装材料业务。

（2）终端应用场景标准严苛，对产品质量和稳定性提出更高要求，有必要通过引进先进设备加以保障

公司半导体封装材料产品主要应用于功率器件，重点服务于汽车电子及新能源领域。该类应用场景对封装材料在导热性能、电气绝缘性能、安全可靠性及长期稳定性等方面均提出了较高要求：一方面，功率器件在高压、大电流工况下运行，热量集中释放，若封装材料导热能力不足，易引发器件性能衰减甚至失效；另一方面，其工作环境通常处于高压系统中，对封装材料的绝缘性和阻燃性要求严格，以防止漏电、短路及过热风险。同时，在频繁的启停、充放电切换等复杂工况下，器件需长期承受热应力和机械应力反复作用，这对封装材料的结构稳定性、抗冲击能力及抗老化性能提出了更高要求。一旦封装材料发生失效，将可能影响整套系统的安全性和可靠性。

基于上述下游应用领域的高标准要求，本项目拟新增引线框架及高导热铜针式散热底板等产品产能，终端主要应用于新能源汽车等领域。为确保产品在性能一致性、质量稳定性及长期可靠性方面满足下游客户要求，公司有必要引进更先进的生产加工及配套检测设备，进一步提升制造精度和过程控制水平，从而为项目产品的高质量交付和稳定运行提供有力保障。

（3）工艺向前端延伸，增强公司市场竞争力

目前，公司引线框架产品的生产工艺主要集中于精密冲压等后端成形环节。为进一步提升产品性能水平和市场竞争力，公司拟将关键工艺向前端延伸，新增异形铜带精密锻打工艺，强化对核心基材质量和性能的自主可控能力。锻打工艺是异形铜带加工成型的核心技术路径，通过高频精密锻压可使铜材形成预定异形结构，并有效优化材料微观组织，改善晶粒度和残余应力分布，从而提升材料的强度、导电性和导热性能。高质量的异形铜带锻打工艺，有助于显著提升引线框架产品的一致性和可靠性，是保障其基础品质的重要前提。

基于上述考虑，本项目拟购置高速精密锻压机、锻压力监控系统等关键软硬件设备，建设异形铜带锻打工艺生产线。一方面，通过将关键基材加工环节纳入公司自身工艺体系，有助于降低对外部供应的依赖、提升生产协同效率；另一方面，可进一步增强对产品性能和质量稳定性过程控制能力，提升客户认可度，并在规模化生产条件下降低综合制造成本。项目实施后，将有利于公司在引线框架产品性能、成本控制及交付能力等方面形成综合优势，持续提升市场竞争力。

4、项目实施的可行性

（1）国家政策支持产业发展，为项目提供良好的外部环境

半导体产业是国民经济的重要组成部分，具有战略性、基础性和先导性，其中封装环节在半导体产业链中占据重要地位，而半导体封装材料则深刻影响了封装产品的性能、寿命、可靠性和最终应用。近年来，国家出台了一系列政策鼓励和扶持行业，以推动半导体封装及下游新能源汽车、新型储能、光伏等相关产业技术进步和行业持续健康发展。2020年9月国家发改委、科技部、工信部、财政部联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，文件明确了聚焦重点产业投资领域，加快在包括电子封装材料在内相关内容的多个领域实现突破。2021年3月中共中央、全国人大发表《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键技术创新应用，

增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2023年6月工信部、教育部、科学技术部、财政部、国家市场监督管理总局联合发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件。提升芯片先进封装材料等电子材料性能，提高元器件封装及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平。

综上所述，相关规划和产业政策大力支持半导体封装、新能源汽车、新型储能、光伏等相关行业的持续发展，本项目符合国家的政策导向，相关政策为项目的开展提供了有利的宏观环境和政策基础，创造了良好的发展机遇。

（2）公司优质的下游客户资源，为项目新增产能顺利消化提供可靠支撑

公司在半导体封装材料领域深耕多年，已建立覆盖封测厂、IDM厂商及芯片设计公司配套体系的下游客户网络，并与多家行业头部客户保持稳定合作关系。公司产品广泛应用于汽车电子、功率器件及工业控制等终端场景，对应客户需求具备长期性和成长性。同时，公司持续加大市场开拓力度，凭借优质产品质量赢得下游客户认可，半导体封装材料业务销售业绩快速增长。

随着先进封装渗透率提升及国产化配套需求持续增强，下游客户对高一致性、高可靠性的关键封装材料需求有望进一步释放。募投项目建成后，公司可依托既有客户基础和在研项目储备，推动产品在更多型号和客户体系中实现导入与放量，为新增产能消化提供可靠支撑，从而增强项目可行性和市场回报预期。

（3）人员与技术储备完善，为募投项目顺利实施提供有力保障

公司在半导体封装材料领域深耕多年，围绕材料研发、结构设计、工艺开发、质量控制及产业化导入等关键环节，逐步形成了一支专业背景多元、实践经验丰富、结构相对稳定的技术与工程团队。核心成员长期从事半导体封装材料及精密制造相关工作，在高导热金属材料、精密成形工艺、表面处理、连接工艺及可靠性验证等方面积累了系统性技术经验，能够覆盖募投项目从前期研发设计、中试验证到规模化生产的全流程需求。

在技术储备方面，公司已建立较为完善的研发与试验体系，具备材料性能评估、工艺参数优化、结构设计与热管理仿真、样品试制及可靠性测试等能力。相

关技术成果已在现有半导体封装材料产品中实现产业化应用，并通过下游客户验证，具备较强的工程化和可复制性。募投项目所涉及的核心工艺与技术路径，与公司现有技术体系在材料体系、加工工艺及质量控制维度具有高度协同性，可在现有技术平台和团队基础上快速导入和实施。

公司在人员结构、技术积累及研发组织体系等方面均已具备较为成熟的基础，能够有效支撑募投项目的实施、达产及后续产品升级，人员与技术储备条件充分，项目具备良好的可行性。

5、项目建设涉及的政府报批情况

截至本报告出具日，本项目的境外投资等相关报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

6、本项目的经济效益

本项目有助于扩大业务规模，具有良好的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

（三）液冷研发中心及集团信息化建设项目

1、项目内容概述

要素	内容	
项目名称	液冷研发中心及集团信息化建设项目	
	液冷研发中心建设项目	集团信息化建设项目
项目实施主体	澄天科泰（惠州）	澄天伟业
项目实施地点	广东省惠州市已租赁场地	深圳市已租赁场地
实施周期	36 个月	36 个月
项目主要建设内容	本项目计划购置先进的研发及检测软硬，并通过对现有场地进行装修改造，建设高标准的实验室，加大研发资源的投入，围绕液冷技术及产品开展一系列相关研发课题，包括“微通道液冷板研发”“可控相变技术研发”“工艺技术提升”等	本项目将以公司现有信息系统架构为基础，通过重新规划公司信息系统架构，为公司新增和升级改造主营业务相关的信息化系统。

2、项目投资概况

本项目计划投资资金 11,391.57 万元，其中，装修改造 194.92 万元，软硬件购置 6,493.15 万元，研发及开发费用 4,703.50 万元，拟使用募集资金 10,700.00 万元，投资构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比（%）
1	装修改造	194.92	1.71
2	软硬件购置	6,493.15	57.00
3	研发及开发费用	4,703.50	41.29
项目总投资		11,391.57	100.00

3、项目实施的必要性

(1) 研发工作对实验设备及环境提出更高要求，募投项目实施具有必要性

液冷服务器属于典型的技术密集型领域，涉及热管理、材料科学、精密制造等多学科交叉，技术门槛高，对专业化实验设备和高标准实验环境依赖程度高。例如，微通道液冷板需在封装材料内部加工微米级流道，其结构复杂、工艺精度要求高，对产品性能、内部结构及焊接质量的检测已显著超出常规冷板标准，需借助工业 CT、金相显微镜等高精度检测设备进行系统性验证。同时，随着液冷产品型号和应用场景不断丰富，研发任务数量和复杂度同步提升，对电子实验、理化测试及高温可靠性验证等实验条件提出更高要求。

公司拟通过本募投项目，系统性引入先进研发及检测软硬件设备，并对现有场地进行装修改造，建设符合液冷产品研发特点的高标准实验室体系。项目实施有助于完善公司研发基础设施，提升研发效率和实验验证能力，缩短产品开发周期，增强对下游客户的快速响应能力，为公司液冷业务的持续技术升级和规模化发展提供有力支撑。因此，本募投项目的实施具有充分的必要性。

(2) 提高公司信息化管理水平，积极响应下游客户高标准合作需求

公司主要服务于半导体、新能源、人工智能及数据中心等高技术产业，下游客户普遍具有技术复杂度高、质量与合规要求严、产品迭代快等特点，并已建立较为完善的信息化管理体系，对供应链合作伙伴的信息化水平提出了明确且持续提升的要求。

信息化系统建设是支撑公司实现产品全生命周期管理、提升质量稳定性和运营效率的重要基础。通过在研发、采购、生产、质量控制及售后等环节强化信息化管理，可有效提升业务流程规范化水平，增强生产过程可控性、结果一致性及产品可追溯性，满足车规级、半导体级等高标准应用场景要求。

结合半导体封装材料、服务器液冷等业务特点，公司拟通过本募投项目升级现有 ERP、OA、HR 系统，并新增 PLM、MES、SRM、CRM、BI 等信息化系统，配套建设数据机房。项目实施有助于公司更好地满足下游客户在质量管控、合规管理及协同研发方面的要求，提升产业链协同能力和综合竞争力，因此具有充分的必要性。

4、项目实施的可行性

（1）公司具备液冷相关核心技术及工艺基础，研发项目具有良好可行性

公司依托多年在高导热金属材料、精密蚀刻、电镀及金属焊接等半导体封装领域积累的核心工艺能力，顺利切入液冷热管理赛道，已构建起液冷产品的核心制造与验证体系，具备从结构设计、材料选型到系统集成的综合技术能力。

目前，公司液冷产品已完成多轮技术验证，通过部分重点客户的样品测试与认证，并实现小批量产品交付，公司液冷业务已形成较为扎实的技术基础。在此基础上，公司围绕客户在超高功率密度应用场景下的核心散热需求，持续推进液冷技术迭代升级。本项目拟开展的微通道液冷板研发、可控相变技术研发及工艺提升等课题，均以推动下一代液冷产品研发及产业化为目标，研发方向明确、应用场景清晰。

综上，公司具备成熟的研发体系和良好的液冷技术基础，本项目所涉前瞻性液冷研发课题紧密围绕下游客户核心需求展开，已取得阶段性成果，具备较强的技术可行性，为项目顺利实施提供了有力保障。

（2）国家政策支持企业数字化发展，成熟的信息技术为项目实施提供有力保障

随着数字经济深入发展，新一代信息技术与制造业加速融合，信息化水平已成为企业提升管理效率和核心竞争力的重要基础。近年来，国家高度重视制造业

数字化转型，陆续出台多项支持政策，持续引导企业加强信息化和数字化能力建设。

从技术条件看，当前信息技术及信息服务市场已较为成熟，ERP、PLM、MES、SRM等核心信息系统在制造业中得到广泛应用，相关软件产品和实施服务具备较高的稳定性和可复制性，能够根据不同行业和企业特点提供定制化解决方案，技术风险相对可控。本次项目拟在集团层面统筹推进信息化建设，通过对业务流程、内控节点及管理体系的持续梳理和优化，实现业务操作与管理标准化、规范化，并在实际运行过程中根据需求反馈不断完善系统功能。本次信息化建设项目所涉及系统均已行业内得到广泛验证，实施风险较低，具备良好的技术可行性，为项目顺利推进提供了有力保障。

5、项目建设涉及的政府报批情况

截至本报告出具日，本项目的备案、环评等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

6、本项目的经济效益

本项目有利于提升公司创新能力，增强公司液冷相关技术和产品的竞争实力，有效增强公司前沿科技研究能力，加速公司科研成果转化，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展。本项目不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟使用募集资金中的8,000万元用于补充流动资金，以满足公司规模不断扩张对营运资金的需求，提高公司资源配置效率，为公司的稳步持续发展提供保障。

2、项目实施的必要性

（1）公司的发展战略需要充足营运资金的支持

为持续深化公司发展战略，优化公司业务结构，拓展公司在算力基础设施及

半导体等下游高景气领域的应用空间，公司将通过提升公司现有人员素质，引入外部优秀人才及团队、提高公司管理效率、研发能力、技术水平、产品与服务质量，以全面增强公司核心竞争力。公司未来需要充足的营运资金支持技术研发、软硬件购置、人才引进等以提升核心竞争力、推动业务模式不断创新，快速占领市场，提升经营效益。

(2) 提升公司抗风险能力，保障财务稳健安全

本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有助于增加公司的流动资金，降低公司的资产负债率，有利于提升公司抗风险能力，提高公司的偿债能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

3、项目实施的可行性

(1) 募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金过程依照相关法律、法规和规范性文件的规定进行，执行过程合法规范，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展。

(2) 公司内部治理规范，内控完善

公司目前已建立完善的以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

四、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响

本次发行募集资金拟投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，具有良好的发展前景和综合效益，有助于巩固和夯实公司的业务优势，提升公司的核心竞争力，增强公司的综合实力。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次募投项目完成后，公司的总资产与净资产规模将同时增加，从而降低公司的资产负债率，有利于公司降低财务风险、增强抗风险能力，优化公司整体财务状况；但由于公司募集资金投资项目的经营效益需要一定的时间才能体现，短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。

本次发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主营业务开展，募集资金项目顺利实施后，公司在液冷散热及半导体封装材料领域的优势将进一步得以提升，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，增强公司的核心竞争力，提高公司的行业地位和市场影响力。

五、可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向。本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司研发技术水平，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 16 日